



2024年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2023年10月31日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <https://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 2023年11月9日 配当支払開始予定日 2023年12月1日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)
 (百万円未満切捨て)

1. 2024年3月期第2四半期の連結業績(2023年4月1日~2023年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年3月期第2四半期	119,698	7.1	7,153	8.8	6,253	20.1	4,551	27.0
2023年3月期第2四半期	111,769	35.0	6,573	138.4	5,208	109.9	3,584	35.5

(注) 包括利益 2024年3月期第2四半期 5,555百万円(21.1%) 2023年3月期第2四半期 4,585百万円(45.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年3月期第2四半期	152.17	—
2023年3月期第2四半期	120.56	—

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年3月期第2四半期	146,342	42,392	28.2
2023年3月期	143,452	38,997	26.4

(参考) 自己資本 2024年3月期第2四半期 41,289百万円 2023年3月期 37,848百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年3月期	—	145.00	—	210.00	355.00
2024年3月期	—	183.00	—	—	—
2024年3月期(予想)	—	—	—	70.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期(予想)の1株当たり期末配当金については、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」と記載しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の2024年3月期(予想)の期末配当金は210円00銭、年間配当金は393円00銭となります。

3. 2024年3月期の連結業績予想(2023年4月1日~2024年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	250,000	4.0	13,500	8.2	9,770	11.3	326.12

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期の連結業績予想における通期の1株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮しております。なお、当該株式分割を考慮しない場合の1株当たり当期純利益は、978円36銭となります。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料8ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2024年3月期2Q	31,336,500株	2023年3月期	31,336,500株
------------	-------------	----------	-------------

② 期末自己株式数

2024年3月期2Q	1,378,080株	2023年3月期	1,490,898株
------------	------------	----------	------------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

2024年3月期2Q	29,908,998株	2023年3月期2Q	29,735,658株
------------	-------------	------------	-------------

(注) 当社は、役員報酬BIP信託、株式付与ESOP信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

(注) 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報)	9
(収益認識関係)	9
(重要な後発事象)	10
3. その他	12
(1) 仕入、受注及び販売の状況	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、ウクライナ情勢の長期化、中国経済の先行き懸念、資源価格の高止まりや物価上昇等の景気減速要素があるものの、新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行等に伴い経済活動が活発化し、景況感は回復傾向となりました。

当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の経営成績については、売上高119,698百万円（前年同期比7.1%増）、営業利益7,153百万円（前年同期比8.8%増）、経常利益6,253百万円（前年同期比20.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益4,551百万円（前年同期比27.0%増）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

当社グループ取扱い半導体製品の需要・供給バランスが改善傾向にあることなどから、産業機器向け、車載向け半導体製品の販売が堅調に推移しました。また、顧客商権が拡大したほか、産業機器向け、医療機器向けの設計・量産受託サービスも堅調に推移したこと、加えて、ドル建て販売において為替相場が円安傾向で推移したことも寄与し、当第2四半期連結累計期間は外部顧客への売上高105,344百万円（前年同期比6.3%増）、セグメント利益（経常利益）4,990百万円（前年同期比15.9%増）となりました。

(コンピュータシステム関連事業)

クラウドへの移行やセキュリティ対策といった企業のIT投資は引き続き堅調であり、セキュリティ関連製品、サブスクリプション型ライセンス及びサービスの販売は引き続き好調に推移しております。また、ネットワーク関連製品の販売についても納期が改善傾向にあることなどから堅調に推移しており、当第2四半期連結累計期間は外部顧客への売上高14,353百万円（前年同期比13.3%増）、セグメント利益（経常利益）1,263百万円（前年同期比39.9%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は146,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,889百万円の増加となりました。これは主に、売上債権が減少した一方で、棚卸資産が増加したことによります。負債総額は103,949百万円となり、前連結会計年度末に比べ505百万円の減少となりました。これは主に、前受金が増加した一方で、買掛金が減少したことによります。また、純資産は42,392百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,395百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は28.2%となり、前連結会計年度末に比べ1.8ポイント向上いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第2四半期連結累計期間の業績については半導体及び電子デバイス事業が堅調であったことに加え、ドル建て販売において為替相場が円安傾向で推移したことも寄与し、売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益いずれも当初の予想を上回る結果となりました。

今後の見通しについては、中国経済の減速をはじめとする世界的な景気の先行き不透明感や半導体を巡るサプライチェーン全体での在庫調整が長引きつつあるものの、顧客商権の拡大及び車載向け半導体製品の販売が堅調に推移することを想定し、2024年3月期の通期連結業績予想につきまして、売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益いずれも次のとおり増額修正することといたしました。

	売上高	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
前回（2023年4月27日） 発表予想（A）	百万円 230,000	百万円 12,000	百万円 8,450	円 銭 283.12
今回修正予想（B）	250,000	13,500	9,770	326.12
増減額（B-A）	20,000	1,500	1,320	—
増減率（%）	8.7	12.5	15.6	—
（ご参考）前期連結実績 （2023年3月期）	240,350	12,478	8,778	294.83

（注）当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,538	6,502
受取手形、売掛金及び契約資産	57,737	52,870
電子記録債権	4,801	5,176
商品及び製品	40,402	48,006
原材料	2,680	3,190
前払費用	17,332	17,254
その他	4,821	3,597
貸倒引当金	△4	△81
流動資産合計	134,309	136,517
固定資産		
有形固定資産	3,481	3,360
無形固定資産	226	628
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	352	374
その他	5,126	5,784
貸倒引当金	△43	△324
投資その他の資産合計	5,435	5,834
固定資産合計	9,143	9,824
資産合計	143,452	146,342

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2023年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	20,214	17,594
短期借入金	20,949	21,117
1年内返済予定の長期借入金	3	5,000
未払法人税等	2,827	1,793
前受金	21,082	23,421
賞与引当金	2,706	2,269
その他	2,811	3,711
流動負債合計	70,595	74,906
固定負債		
長期借入金	24,700	19,700
退職給付に係る負債	7,626	7,540
その他	1,533	1,802
固定負債合計	33,859	29,043
負債合計	104,455	103,949
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,652	5,684
利益剰余金	30,482	32,839
自己株式	△1,813	△1,716
株主資本合計	36,816	39,302
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	82	89
繰延ヘッジ損益	△136	111
為替換算調整勘定	973	1,683
退職給付に係る調整累計額	111	101
その他の包括利益累計額合計	1,031	1,986
非支配株主持分	1,148	1,103
純資産合計	38,997	42,392
負債純資産合計	143,452	146,342

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
売上高	111,769	119,698
売上原価	95,706	101,686
売上総利益	16,062	18,011
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	3,574	3,708
賞与引当金繰入額	1,724	2,141
退職給付費用	324	357
従業員株式報酬引当金繰入額	64	130
貸倒引当金繰入額	△3	358
その他	3,805	4,163
販売費及び一般管理費合計	9,489	10,858
営業利益	6,573	7,153
営業外収益		
保険配当金	43	42
持分法による投資利益	62	93
その他	54	48
営業外収益合計	160	185
営業外費用		
為替差損	1,431	923
その他	92	161
営業外費用合計	1,524	1,085
経常利益	5,208	6,253
特別利益		
投資有価証券売却益	-	4
特別利益合計	-	4
特別損失		
固定資産除却損	2	1
特別損失合計	2	1
税金等調整前四半期純利益	5,206	6,256
法人税等	1,557	1,655
四半期純利益	3,648	4,601
非支配株主に帰属する四半期純利益	63	50
親会社株主に帰属する四半期純利益	3,584	4,551

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
四半期純利益	3,648	4,601
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△18	7
繰延ヘッジ損益	123	247
為替換算調整勘定	821	676
退職給付に係る調整額	△23	△10
持分法適用会社に対する持分相当額	33	32
その他の包括利益合計	937	954
四半期包括利益	4,585	5,555
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	4,522	5,505
非支配株主に係る四半期包括利益	63	50

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	5,206	6,256
減価償却費及びその他の償却費	289	275
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△3	357
賞与引当金の増減額 (△は減少)	83	△447
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△152	△97
従業員株式報酬引当金の増減額 (△は減少)	65	136
役員株式報酬引当金の増減額 (△は減少)	66	101
支払利息	60	122
為替差損益 (△は益)	531	999
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	△7,564	5,494
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△10,405	△7,728
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,065	△2,723
未払金の増減額 (△は減少)	△28	155
前受金の増減額 (△は減少)	3,725	2,327
未収消費税等の増減額 (△は増加)	316	1,275
未収入金の増減額 (△は増加)	128	75
前払費用の増減額 (△は増加)	△2,753	80
前渡金の増減額 (△は増加)	△97	125
その他	△1,065	△1,194
小計	△9,530	5,591
利息及び配当金の受取額	57	56
利息の支払額	△61	△122
法人税等の支払額	△1,998	△2,628
営業活動によるキャッシュ・フロー	△11,532	2,895
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額 (△は増加)	17	△7
有形固定資産の取得による支出	△80	△143
無形固定資産の取得による支出	△15	△444
投資有価証券の売却による収入	-	4
敷金及び保証金の差入による支出	-	△428
保険積立金の解約による収入	47	-
その他	△0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32	△1,018
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	12,367	△119
長期借入金の返済による支出	△169	△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△27
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	133	229
配当金の支払額	△989	△2,089
非支配株主への配当金の支払額	△17	△35
リース債務の返済による支出	△31	△37
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,290	△2,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	133	163
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△140	△42
現金及び現金同等物の期首残高	5,028	6,442
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,887	6,400

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	99,098	—	99,098	—	99,098
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	7,608	7,608	—	7,608
保守・監視サービス	—	5,062	5,062	—	5,062
顧客との契約から生じる収益	99,098	12,670	111,769	—	111,769
外部顧客への売上高	99,098	12,670	111,769	—	111,769
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	—	2	△2	—
計	99,101	12,670	111,771	△2	111,769
セグメント利益	4,305	903	5,208	—	5,208

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	105,344	—	105,344	—	105,344
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	8,561	8,561	—	8,561
保守・監視サービス	—	5,792	5,792	—	5,792
顧客との契約から生じる収益	105,344	14,353	119,698	—	119,698
外部顧客への売上高	105,344	14,353	119,698	—	119,698
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	105,344	14,353	119,698	—	119,698
セグメント利益	4,990	1,263	6,253	—	6,253

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。

(重要な後発事象)

1. 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

当社は、2023年4月27日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を決議し、2023年10月1日でその効力が発生しております。

(1) 株式分割の目的

投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家がより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることを目的としております。

(2) 株式分割の概要

① 分割の方法

2023年9月30日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2023年9月29日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記録された株主が所有する当社普通株式を1株につき3株の割合をもって分割しております。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	10,445,500 株
今回の分割により増加する株式数	20,891,000 株
株式分割後の発行済株式総数	31,336,500 株
株式分割後の発行可能株式総数	76,800,000 株

③ 分割の日程

基準日公告日	2023年9月14日
基準日	2023年9月30日
効力発生日	2023年10月1日

(3) 1株当たり情報に及ぼす影響

1株当たり情報に及ぼす影響は、サマリー情報の「1株当たり四半期純利益」に反映しております。

(4) 定款の一部変更

① 定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づく取締役会決議により、2023年10月1日をもって当社定款第6条に定める発行可能株式総数を変更しております。

② 定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部が変更箇所)

現行定款	変更後定款
第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>25,600,000 株</u> とする。	第6条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、 <u>76,800,000 株</u> とする。

③ 定款変更の日程

取締役会決議日	2023年4月27日
効力発生日	2023年10月1日

(5) その他

今回の株式分割に際して、当社の資本金の額の増減はありません。

2. 事業の譲受

当社は、2023年9月14日開催の取締役会（みなし決議）において、日本エレクトロセンサリデバイス株式会社より、同社事業の一部である「ウェーハ検査装置事業」を譲り受けることについて決議し、2023年9月15日に同社との間で事業譲渡契約を締結いたしました。

(1) 事業譲受の目的

当社は、2020年よりウェーハ検査装置事業を開始し、日本国内を中心に販売活動を行っております。今後継続的な成長が見込まれる半導体製造装置市場において、ウェーハ検査装置の拡充及び検査技術の強化を行い、海外への事業展開を加速することで、将来の更なる事業領域の拡大と収益性の向上に資すると判断し、本事業を譲り受けることを決議いたしました。

(2) 事業譲受の概要

① 相手先企業の名称及び譲受事業の内容

相手先企業の名称 日本エレクトロセンサリデバイス株式会社

譲受事業の内容 ウェーハ検査装置事業

② 事業譲受日 2023年10月2日

③ 事業譲受の法的形式 現金を対価とする事業譲受

(3) 譲受事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	1,200百万円
取得原価		1,200百万円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 64百万円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定していません。

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定していません。

3. その他

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	99,724	3.2
コンピュータシステム関連事業	10,268	△0.5
合計	109,992	2.9

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	80,964	△42.1	142,128	△26.1
コンピュータシステム関連事業	12,872	△35.7	33,903	△1.5
合計	93,837	△41.3	176,031	△22.4

③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	105,344	6.3
コンピュータシステム関連事業	14,353	13.3
合計	119,698	7.1